证券代码：301611　　证券简称：珂玛科技　　公告编号：2026-026

苏州珂玛材料科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本436,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	珂玛科技	股票代码	301611
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	仇劲松	雷梦思	
办公地址	江苏省苏州市高新区新锐路1号	江苏省苏州市高新区新锐路1号	
传真	0512-66918281	0512-66918281	
电话	0512-68088521	0512-68088521	
电子信箱	jerry.qiu@kematek.com	mlei@kematek.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司所处行业情况：

全球半导体市场规模和半导体制造设备支出显示出强劲的增长态势，主要是由于AI、云基础设施、先进消费电子产品等领域的持续需求所带动。根据WSTS数据，2025年全球半导体市场规模持续攀升，全年全球半导体市场规模将达到7,009亿美元，同比增长11.2%；2026年的全球半导体市场规模预计将进一步上升8.5%至7,607亿美元。根据SEMI数据，2024年全球半导体制造设备销售总额达1,170亿美元历史纪录，同比增加10%，创下历史新高；2025年、2026年预计将延续上升势头，分别达1,215亿美元、1,394亿美元，分别同比增加4%、19%。全球半导体行业预计将在2025年启动18个新晶圆厂建设项目，其中包括3座8英寸和15座12英寸新晶圆厂，大部分预计将于2026年至2027年开始运营，这一扩产趋势也得到了Knometa Research追踪数据的印证，其指出2025年全球将有17条新晶圆产线实质性投入运营，涵盖了逻辑代工、存储和模拟芯片等多个关键领域，推动全球晶圆产能创下历史新高。

中国大陆仍然稳居全球半导体设备支出龙头。根据SEMI数据，2025年中国大陆半导体设备支出总值约493亿美元，中国大陆预计在2025年新启动3座晶圆厂建设项目，根据芯谋研究数据，受供应链日主可控需求驱动，国产替代进程大幅加速，中国半导体设备国产化率在2025年已攀升至35%，全面进入核心加速期。半导体设备在成熟制程领域国产化已取得显著进展，但先进制程领域的高端设备仍需突破“卡脖子”环节，未来国产替代空间广阔。在我国大力扶持半导体产业的背景下，全球半导体及上游零部件全产业链产能向中国大陆转移，在国产化背景趋势下，预计未来中国大陆半导体领域市场需求在阶段性波动恢复后将继续保持平稳较快增长。

从国际层面来看，全球半导体设备先进结构陶瓷市场继续保持增长态势，来自日本、美国、韩国和欧洲的供应商在不同部分市场和技术领域保持领先地位，尤其在半导体设备关键部件“功能-结构”模块类产品方面，例如陶瓷加热器、静电卡盘以及超高纯碳化硅套件等，通常为全球半导体设备厂商和晶圆厂商的首选供应商，包括国内半导体设备厂商和晶圆厂商。

（2）公司主要产品及服务：

（a）先进陶瓷材料零部件：

公司先进陶瓷业务的基础是材料，产品形式是高度定制化的零部件，最终端应用于半导体、新能源等多个国民经济重要行业。公司掌握了从材料配方到零部件制造的先进陶瓷全工艺流程技术，目前已量产氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化铝5大类材料先进陶瓷材料，累计设计开发了一万余款定制化零部件。

公司先进陶瓷材料零部件应用于多个领域，按领域区分的产品情况如下：

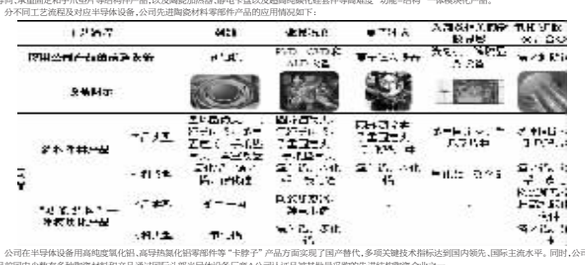
（i）半导体领域

半导体设备零部件是公司报告期内先进陶瓷产品的最主要应用。半导体设备是半导体产业的基础支撑，其中的道工艺主要完成晶圆制造，该等工艺设备类型繁杂，技术难度较高。半导体设备由腔室内和腔室外组成，陶瓷大部分用在更接近晶圆的腔室内，其技术要求严苛，须在先进陶瓷材料性能、硬脆难加工材料精密加工及新品表面处理等方面阐足客户要求。

公司先进陶瓷主要应用于晶圆制造前道工艺设备，目前已进入刻蚀、薄膜沉积、离子注入、光刻和氧化扩散等多种设备，是国内半导体设备用先进陶瓷材料零部件的头部企业。

公司用于半导体设备的先进陶瓷材料零部件产品主要应用于腔室内，其中部分零部件直接与晶圆接触，是集成电路制造中关键的精密零部件，包括圆环圆筒、气流导向、承重固定和手爪垫片等结构件产品，以及陶瓷加热器、静电卡盘以及超高纯碳化硅套件等高难度“功能-结构”一体模块化产品。

分不同工艺流程及对应半导体设备，公司先进陶瓷材料零部件产品的应用情况如下：



公司在半导体设备用高纯度氧化铝、高导热氮化铝零部件等“卡脖子”产品方面实现了国产替代，多项关键技术指标达到国内领先、国际主流水平。同时，公司亦是目前国内少数有多种陶瓷材料和产品通过国际头部半导体设备厂商A公司认证且被其批量采购的先进结构陶瓷企业之一。

此外，公司从2016年承接国家“02专项”课题起，不断完善核心材料配方并攻克了多项复杂工艺，是国内较早切入“功能-结构”一体模块化产品研发、客户验证并批量生产的企业。公司目前主要“功能-结构”一体模块化产品研发和产业化进展如下：

（ii）泛半导体领域

在显示面板制造、LED制造及光伏制造等方面，公司已量产用于刻蚀、PVD、CVD设备和工艺连接器等的先进陶瓷材料零部件。

（iii）其他领域

在电子（包括锂电池）材料粉体粉碎和分级领域，公司主要生产砂磨机涡轮、分级机分级轮、三辊机轧辊等先进陶瓷材料零部件，凭借高硬度、高韧性特点，它们被使用在多种粉体粉碎和分级设备上，作为核心零部件，发挥研磨、击碎、摩擦、分离和筛选等关键功能。公司作为国内本土企业的代表实现了关键零部件如“分级轮”的国产化，“分级轮”产品的最大运转线速度超过60m/s，分级粒度可达到 μm，上述两项关键性能指标均已达到全球主流水平。

此外，在汽车制造领域，公司主要生产氧化锆、氧化铝材质的焊装销和定位销等产品，焊装销被用在中高端汽车的生产焊接设备，起到高温、火花保护等功能，定位销被用在汽车的装配过程中，起到定位的功能；在纺织领域，公司针对不同纱线类型调整材料配方并设计晶粒规格，改变先进陶瓷表面粗糙度等表面结构，发挥引导及保护纱线的功能；在生物医药领域，生物医药中的剂注射、灌装等工序设备对零部件的耐腐蚀性要求高，公司已生产并销售用于高压均质机的陶瓷棒、隔离套等生物医药设备零部件产品。

（b）表面处理服务：

公司表面处理服务面向显示面板制造厂和设备制造原厂，主要为显示面板工艺设备零部件提供清洗和再生改造服务。通过精密清洗、阳极氧化和喷射等主要手段，以洗净再生、烧蚀再生等综合解决方案为先进陶瓷、石英、金属等多种类型的设备零部件进行阶段性污染物控制，提高部件耐腐蚀性等性能，以保障显示面板制造工艺稳定，提高大规模制造良率。公司服务于多家全球知名显示面板制造企业，具备较强的综合服务能力，在表面处理的洁净度、耐用性等关键指标上客户反馈良好，赢得了较高的市场声誉。

表面处理还是先进陶瓷材料零部件新品制造的重要后道工序之一。公司采用精密清洗严格量化控制表面颗粒物、金属离子等污染物，并采用喷砂和喷射等形成特定表面涂层和形貌。这些特殊工艺能力也属于陶瓷产品生产的核心技术。

（3）公司主营业务增长的驱动因素：

公司主营业务收入主要为先进陶瓷材料零部件销售收入，其他材料零部件销售收入以及泛半导体设备表面处理服务收入，收入规模逐年增长，合计占营业收入的比例在95%以上，公司主营业务突出。其他业务收入主要为零部件加工服务收入及贸易业务收入等，占营业收入的比重较小。

（a）先进陶瓷材料零部件：

公司在2025年度及2024年度先进陶瓷材料零部件的营业收入分别为97,321.91万元和76,819.56万元，2025年比去年同期增长26.68%。

先进陶瓷材料零部件的下游主要应用领域包括半导体、泛半导体、粉体粉碎和分级等领域，各领域收入规模及占比情况具体如下：

单位：人民币万元

应用领域	产品	2025年度		2024年度	
		金额	占比	金额	占比
半导体领域	结构件产品	55,253.98	56.78%	40,111.89	52.22%
	“功能-结构”一体模块化产品	32,330.67	33.22%	29,077.07	37.85%
泛半导体领域		3,410.52	3.50%	3,216.68	4.19%
粉体粉碎和分级领域		3,227.61	3.32%	3,181.33	4.14%
其他领域		3,090.13	3.18%	1,232.59	1.60%
合计		97,312.91	100.00%	76,819.56	100.00%

半导体领域是公司产品的主要应用方向，公司在2025年度及2024年度来自半导体设备领域的先进陶瓷材料零部件收入分别为87,584.45万元和69,188.96万元，占先进陶瓷材料零部件收入的比例分别为90.00%和90.07%，2025年比去年同期增长26.58%。

2025年度，得益于中国半导体市场持续扩张，中国半导体产业规模的快速增长以及设备国产替代程度不断提高，下游半导体领域客户采购需求快速增长，公司订单饱满，带动了公司先进陶瓷材料结构件产品在半导体领域销售收入规模的增长。半导体领域结构件产品2025年销售收入比去年同期增长27.75%。

2025年，半导体设备领域收入的增加也来源于公司“功能-结构”一体模块化产品的持续大规模量产交付，基于多年技术积累、研发及产业化布局，公司半导体设备核心部件陶瓷加热器实现国产替代，该“功能-结构”一体模块化产品解决了半导体晶圆厂商CVD设备关键零部件的“卡脖子”问题。公司为半导体晶圆厂商和国内半导体设备厂商研发生产并销售多款陶瓷加热器产品，装配于SACVD、PECVD、LPCVD和激光退火等设备，部分陶瓷加热器产品已量产并大量应用于扇形的薄膜沉积生产工艺流程，公司在2025年继续着力于陶瓷加热器的性能优化及产品迭代，翻助先进生产基地项目在2025年初投产的优势，优化工艺流程，持续推动产品向客户的稳定交付。同时，静电卡盘与超高纯碳化硅套件也逐步完成验证并开始小批量交付，形成了一定的收入。半导体领域“功能-结构”一体模块化产品，2025年销售收入比去年同期增长11.19%。

2025年，受国内消费电子行业温和复苏的影响，公司来自显示面板、LED和光伏等其他泛半导体的结构件产品的收入小幅增长；国内新能源相关领域已度过产能相对过剩的阵痛期，整体行业保持稳定，故公司粉体粉碎和分级领域收入在2025年度基本保持平稳。

公司先进陶瓷材料零部件应用的其他领域包括能源环保、汽车生产、纺织和生物医药等领域。

（b）表面处理服务：

公司表面处理服务包括溶射再生服务和洗净再生服务，下游均面向泛半导体领域，在2025年度及2024年度收入分别为8,137.15万元和8,204.90万元，基本保持了稳定。公司表面处理服务收入具体构成如下：

单位：人民币万元

项目	2025年度		2024年度	
	金额	占比	金额	占比
熔射再生业务	5,852.68	71.93%	5,511.06	67.17%
洗净再生业务	2,284.47	28.07%	2,693.84	32.83%
合计	8,137.15	100.00%	8,204.90	100.00%

2026年度公司表面处理业务收入规模基本维持稳定。

（c）其他材料零部件：

公司在2025年度及2024年度其他材料零部件产品收入分别为1,225.62万元和328.92万元，呈增长趋势。其他材料零部件主要包括金属零部件、石墨零部件和CVD碳化硅涂层零部件，其中金属零部件主要产品包括上部电极、壁板等，主要用于显示面板生产设备；石墨零部件和CVD碳化硅涂层零部件系苏州锟欣的原有业务，2025年7月公司完成对苏州锟欣的收购后，石墨零部件和CVD碳化硅涂层零部件的销售收入助力了其他材料零部件的收入规模的增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：人民币元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,613,142,474.85	1,967,300,323.94	32.83%	1,349,787,769.82
归属于上市公司股东的净资产	1,776,824,889.80	1,519,409,816.81	16.94%	736,477,633.70
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,073,398,296.26	857,381,991.25	25.19%	480,449,554.09
归属于上市公司股东的净利润	289,087,559.51	310,974,768.28	-7.04%	81,860,699.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,001,958.31	305,752,913.25	-5.81%	77,688,779.54
经营活动产生的现金流量净额	238,988,809.31	229,901,208.58	3.95%	46,586,832.10
基本每股收益（元/股）	0.66	0.81	-18.52%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.81	-18.52%	0.23
加权平均净资产收益率	17.31%	29.32%	-12.01%	11.86%

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	247,892,688.65	272,504,895.75	273,541,457.02	279,459,244.84
归属于上市公司股东的净利润	87,092,902.76	84,770,990.62	72,656,425.02	44,567,241.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,064,692.58	84,482,796.24	72,966,737.95	44,487,731.54
经营活动产生的现金流量净额	66,929,232.16	74,230,380.13	41,350,611.16	56,478,585.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,612	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,929	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘先兵	境内自然人	44.19%	192,649,465.00	192,649,465.00	不适用	0.00
胡文	境内自然人	16.67%	72,676,450.00	72,676,450.00	不适用	0.00
苏州博盈企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.65%	15,925,314.00	15,925,314.00	不适用	0.00
苏州市博睿企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.41%	6,126,729.00	6,126,729.00	不适用	0.00
刘俊	境内自然人	1.25%	5,872,997.00	0.00	不适用	0.00
北京诺华资本投资管理有限公司－北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）	其他	0.92%	4,009,575.00	0.00	不适用	0.00
高建	境内自然人	0.84%	3,683,005.00	0.00	不适用	0.00
深圳华业天成投资有限公司－湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.70%	3,054,481.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	2,934,651.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	2,746,817.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘先兵持有苏州博盈16.24%的财产份额并担任执行事务合伙人，直接持有苏州博睿0.71%的财产份额并担任执行事务合伙人；高建持有苏州博盈19.21%的财产份额；除上述情况之外，未知上述股东相互之间是否存在关联关系或一致行动					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

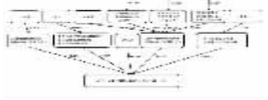
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：301513　　证券简称：尚水智能　　公告编号：2026-002

深圳市尚水智能股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	尚水智能	股票代码	301513
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄伟杰	黄小龙	
办公地址	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区深圳市尚水智能股份有限公司1栋101	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区深圳市尚水智能股份有限公司1栋101	
传真	0755-28380615	0755-28380615	
电话	0755-28380612	0755-28380612	
电子信箱	ir@ss-smart.cn	ir@ss-smart.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司的主营业务围绕微纳粉体处理、粉液精密计量、粉液混合分散、功能薄膜制备等核心工艺环节展开，产品可广泛用于新能源电池、新材料、化工、食品、医药、半导体等行业。目前公司主要面向新能源电池极片制造及新材料制备领域，专业从事融合工艺能力的智能装备的研发、设计、生产与销售。

（二）主要产品及其用途

公司主要产品围绕核心业务分为两大板块，分别为新能源电池极片制造智能装备和新材料制备智能装备，各板块产品均依托公司核心工艺技术平台，精准匹配下游行业生产需求。

1、新能源电池极片制造智能装备

覆盖电池极片制造全工艺路径，既包含当前主流的湿法极片制造系列产品，也布局了半干法、干法等前沿极片制造相关装备，形成对不同技术路线、不同应用场景的全面覆盖，为动力电池、储能电池、3C电池等下游客户提供一体化极片制造装备解决方案。

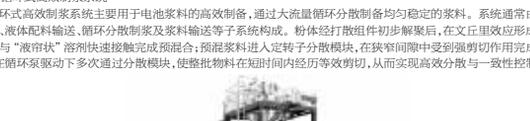
（1）湿法极片制造智能装备

①制浆系统

A、薄膜高速分散制浆系统

薄膜高速分散制浆系统主要用于电池浆料的精细分散，尤其适用于小粒径、大比表面积等难分散材料。系统通常由预混合设备、浆料输送设备及薄膜高速分散单机等组成。预混合浆料进入分散腔体后，在分散轮高速旋转和挡料板作用下形成环形薄膜，并在离心力作用下甩向腔体内壁产生高速撞击，随后返回分散轮内部，经分散孔再次分散；该“吸入—甩出—撞击—再吸入”的过程反复进行，实现浆料的快速解聚与均匀分散，提升一致性与稳定性。

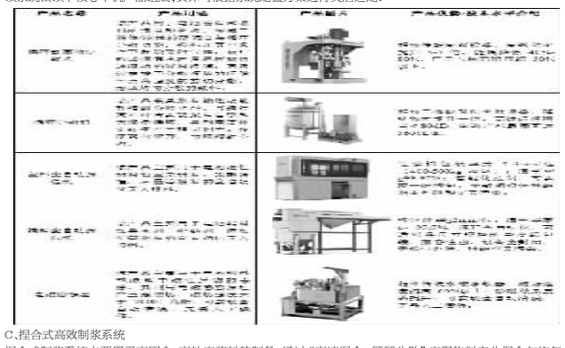
该系统包含以下核心单机产品：



B、循环式高效制浆系统

循环式高效制浆系统主要用于电池浆料的高效制备，通过大流量循环分散制备均匀稳定的浆料。系统通常由粉体配料输送、液体配料输送、循环分散制浆及浆料输送等子系统构成。粉体经打散组件初步解聚后，在文丘里效应形成的负压作用下与“液帘状”溶剂快速接触完成预混合；预混浆料进入定转子分散模块，在狭窄间隙中受到强剪切作用完成初次分散，并在循环泵驱动下多次通过分散模块，使整批物料在短时间内经历等效剪切，从而实现高效分散与一致性控制。

该系统由以下核心单机产品组成，具体可根据系统配置方案进行灵活选配：



C、捏合式高效制浆系统

捏合式制浆系统主要用于高固含、高粘度浆料的制备，通过“高速捏合+循环分散”实现物料充分混合与均匀分散。系统一般由粉体配料、粉液精密计量与输送、捏合预混、循环分散及浆料输送等子系统组成。设备融合高速转子与低速刮刀结构，可对高粘度物料进行强力搅拌、推拉与剪切，实现粉料与液料的充分混合与初步解聚，形成高浓度预混浆料；并结合循环分散模块，对预混浆料进行多次循环剪切与冲击，在定转子之间的高速运动中实现团聚颗粒的进一步解离与均匀分散，从而兼顾高固含加工需求及浆料的均匀性与稳定性。

捏合式高效制浆系统

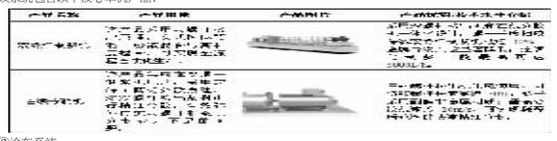
该系统包含以下核心单机产品：

D、双螺杆制浆系统

双螺杆制浆系统主要用于连续化、高固含制浆，通过“双螺杆捏合+连续剪切分散”实现物料输送、混合与精细分散。系统通常包括粉体配料、粉液连续精密计量与输送、双螺杆混合制浆及浆料输送等子系统组成。设备尾端集成高速连续分散模块。浆料在完成双螺杆粉液预混、捏合与稀释后，无需中转即可进入分散模块进行高剪切处理，从而在单一系统内实现均匀、稳定分散，推动制浆过程向连续化、自动化和高效化发展。

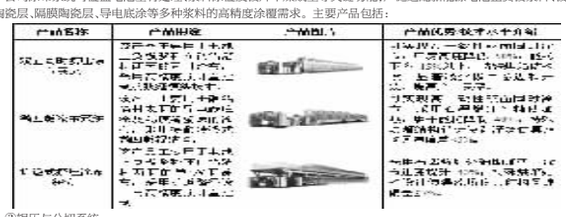
双螺杆制浆系统

该系统包含以下核心单机产品：



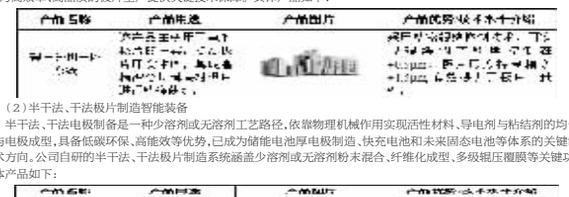
②涂布系统

公司涂布系统可覆盖电池基材处理、浆料涂覆及极片干燥成型等关键功能，广泛适配新能源电池正负极浆料、极片边缘陶瓷层、隔膜陶瓷层、导电底涂等多种浆料的高精度涂覆需求。主要产品包括：



③辊压与分切系统

公司辊压与分切系统依托高精度轧辊调控技术与高精密分切模块，能够同步实现极片的致密化压实与结构完整性控制，为高效率、高品质的极片生产提供关键技术保障。具体产品如下：



（2）半干法、干法极片制造智能装备

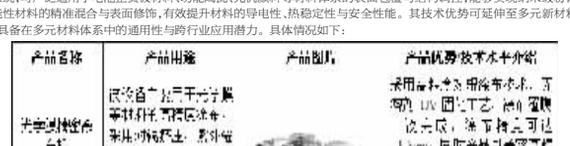
半干法、干法电极制备是一种少溶剂或无溶剂工艺路径，依靠物理机械作用实现活性材料、导电剂与粘结剂的均匀混合与电极成型，具备低碳环保、高能效等优势，已成为储能电池厚电极制造、快充电池和未来固态电池等体系的关键制造技术方向。公司自研的半干法、干法极片制造系统涵盖少溶剂或无溶剂粉末混合、纤维化成型、多级辊压覆膜等关键功能。具体产品如下：

2、新材料制备智能装备

以粉体处理、功能薄膜制备等平台技术为核心，在新能源电池正负极材料、功能膜、半导体封装材料、功能陶瓷材料等细分领域形成特色产品矩阵，针对性解决新材料制备过程中的混合分散、研磨包覆、精密涂布等关键工艺痛点。

（1）功能膜涂布系统

公司新材料功能膜涂布系统目前主要聚焦于溶液涂布型光学膜制备。光学膜涂布是一种在玻璃、PET等基材表面均匀沉积功能材料，以改善透光性、反射率、耐候性等光学性能的精密工艺，常采用溶液涂布、物理气相沉积、化学气相沉积等方式实现，公司采用的光学膜涂布技术以高精度溶液涂布为核心，通过精密控制涂布间隙、辊速、压力等参数，确保涂层厚度一致、表面平整，满足多样化高性能光学膜的制备需求。具体情况如下：



（2）包覆改性系统

混合包覆作为微纳材料物理改性的重要手段，是提升材料性能的关键工序之一。公司自主开发的新材料包覆改性制备系统，可广泛适用于电池正负极材料、功能陶瓷、无机颜料等材料体系的表面包覆与结构调控，能够实现纳米级粉体与功能性材料的精准混合与表面修饰，有效提升材料的导电性、热稳定性与安全性能。其技术优势可延伸至多元新材料领域，具备在多元材料体系中的通用性与跨行业应用潜力。具体情况如下：

③研磨粉碎系统

研磨粉碎是新能源电池材料、半导体封装材料与功能陶瓷材料制备中的关键工序之一。公司新材料研磨粉碎系统主要服务于新能源电池正负极材料、半导体封装材料以及功能陶瓷材料等多个领域。不同类型材料在粒径分布、堆积密度、振实密度、安息角、比表面积、扬尘与流动性等粉体物性参数方面差异显著，对应的研磨粉碎工艺需求亦高度差异化。随着新材料产业快速发展，材料制备正向规模化、多元化、精细化与低碳化方向演进，对设备的适配性、连续性及工艺稳定性提出了更高要求。公司自主研发的研磨粉碎系统充分融合干法与湿法两类技术路径，具备研磨粉碎能量密度高、产品均匀性好、适配材料广等特点。主要情况如下：

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,366,739,281.02	1,799,649,754.03	31.51%	1,570,487,793.08
归属于上市公司股东的净资产	730,488,168.79	567,546,159.33	28.71%	428,696,916.37
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	803,672,962.20	636,594,823.50	26.25%	600,596,598.89
归属于上市公司股东的净利润	156,258,077.84	152,521,436.52	2.45%	234,290,123.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,691,622.13	147,949,400.01	5.23%	219,462,621.14
经营活动产生的现金流量净额	70,312,376.62	-15,395,909.19	556.70%	-72,565,773.96
基本每股收益（元/股）	2.08	2.03	2.46%	3.12
稀释每股收益（元/股）	2.08	2.03	2.46%	3.12
加权平均净资产收益率	24.08%	29.52%	-5.45%	76.74%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	278,622,463.64	119,084,845.22	169,776,696.07	236,188,947.27
归属于上市公司股东的净利润	48,800,499.50	44,906,709.70	28,055,230.80	34,496,637.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,666,458.00	44,947,216.27	27,892,137.30	34,185,810.56
经营活动产生的现金流量净额	82,047,112.76	-15,423,714.64	-45,487,979.52	49,176,958.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
金旭东	境内自然人	35.07%	26,301,724.00	26,301,724.00	不适用	0.00
江苏博众智能科技集团有限公司	境内非国有法人	28.09%	21,068,177.00	21,068,177.00	不适用	0.00
深圳市尚水投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.08%	12,063,206.00	12,063,206.00	不适用	0.00
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	7.69%	5,764,973.00	5,764,973.00	不适用	0.00
苏州赛伯创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.15%	1,613,566.00	1,613,566.00	不适用	0.00
广州市正轩前瞻睿远创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.09%	1,566,569.00	1,566,569.00	不适用	0.00
杨向群	境内自然人	1.93%	1,447,585.00	1,447,585.00	不适用	0.00
谢平波	境内自然人	1.29%	965,057.00	965,057.00	不适用	0.00
赵礼贵	境内自然人	1.00%	750,000.00	750,000.00	不适用	0.00
共青城极客信号创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.83%	625,000.00	625,000.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，金旭东与深圳市尚水商务服务合伙企业（有限合伙）为一致行动人，深圳市尚水商务服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为金旭东。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

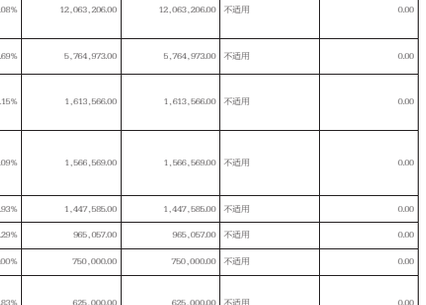
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见《公司2025年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。

证券代码：301513　　证券简称：尚水智能　　公告编号：2026-008

深圳市尚水智能股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等；拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括商业银行、证券公司等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品等；

2、投资金额：公司拟使用不超过人民币5.9亿元的闲置募集资金及不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用；

3、特别风险提示：虽然投资产品均经过严格的评估，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过人民币5.9亿元的闲置募集资金及不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将详细情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市尚水智能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]72号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，每股面值1.00元，发行价为人民币26.66元/股，共计募集资金人民币666,500,000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币591,611,304.47元。募集资金已于2026年4月14日划至公司指定账户。2026年4月14日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]6096号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用与管理情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入额
1	高精智能装备华南总部制造基地建设项目	50,568.15	22,834.67
2	研发中心建设项目	29,609.43	20,903.87
3	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计		95,177.58	58,738.54

公司本次募集资金净额为人民币59,161.13万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为人民币422.59万元。

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目建设。鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施、保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，将充分盘活资金，进一步增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）投资品种

（1）募集资金投资品种

为控制财务风险，公司使用闲置募集资金投资的理财产品，必须符合以下条件：①结构性存款、大额存单